**基于TSV的随机行走技术文档**

TSV输入文件案例的相关几何参数：

TSV: 半径2.5，中心(0, 0, 1.5)，高2.6。

三层导线z坐标：M3 1~1.2 M4 1.4~1.6 M5 1.8~2.0，线宽0.1。

地板: z: -0.1~0，水平: (-15, -10)~(15, 10) //(xmin, ymin)~(xmax, ymax)。

三层导线的俯视图如下：

M3: A (-8, -2.1)~(-3.5, -2), B (3.5, -0.1)~(8, 0), C (-8, 3.5)~(8, 3.6)

C

B

A

M4: D (-5, -5)~(-4.9, 5) E (-3.6, -5)~(-3.5, 5) F(3.5, -5)~(3.6, 5) G (4.9, -5)~(5, 5)

E

D

F

G

M5: H (-8, 3.5)~(8, 3.6), I(-8, -3.6)~(8, -3.5), J (-8, -0.05)~(-3.5, 0.05), K (3.5, -0.05)~(8, 0.05)

H

K

J

I

下面为不同的点行走的转移区域：

分为三种情况，首先判断该点离其它互连线导体近还是离TSV近，如果离其它导体近的话直接用立方体转移即可，因为其它导线都是曼哈顿结构，用立方体可以很好的贴近导体。如下图所示(侧视图)：

**a**

如果该点离TSV导体比较近的话，判断该点到TSV导体的距离是否大于a,a为圆柱体的外切立方体与TSV外边的立方体的距离。如果大于a的话，做立方体转移。

如下图所示（侧视图）

如果该距离小于a的话，做TSV转移.如下图所示（侧视图）